



平成24年7月5日

各位

上場会社名 日置電機株式会社
 代表者 代表取締役社長 吉池 達悦
 (コード番号 6866)
 問合せ先責任者 取締役執行役員総務部長 巢山 芳計
 (TEL 0268-28-0555)

連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成24年1月25日の決算発表時に公表しました連結業績予想を下記のとおり修正いたします。またこれにともない平成24年7月5日開催の当社取締役会において、以下のとおり1株当たり配当予想について修正することといたしましたので、お知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

平成24年12月期第2四半期(累計)連結業績予想数値の修正(平成24年1月1日～平成24年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	8,600	1,300	1,290	830	60.91
今回修正予想(B)	7,900	950	950	610	44.76
増減額(B-A)	△700	△350	△340	△220	
増減率(%)	△8.1	△26.9	△26.4	△26.5	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成23年12月期第2四半期)	8,259	1,081	1,067	771	56.62

平成24年12月期通期連結業績予想数値の修正(平成24年1月1日～平成24年12月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	17,100	2,520	2,500	1,600	117.41
今回修正予想(B)	16,300	2,100	2,100	1,350	99.07
増減額(B-A)	△800	△420	△400	△250	
増減率(%)	△4.7	△16.7	△16.0	△15.6	
(ご参考)前期実績 (平成23年12月期)	15,966	1,948	1,942	1,358	99.69

修正の理由

当社グループの国内売上高は堅調に推移しておりますが、海外半導体メーカーの生産調整により当社自動試験装置の海外売上高が低迷し、また欧州債務危機及び中国の景気引き締め政策の影響等により、海外売上高が全体として不調となりました。売上高及び利益が前回予想数値を下回る見込みとなったため平成24年12月期の連結業績予想を修正いたします。

● 配当予想の修正について

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (平成24年1月25日発表)	—	15.00	—	20.00	35.00
今回修正予想	—	15.00	—	15.00	30.00
当期実績	—	—	—		
前期実績 (平成23年12月期)	—	15.00	—	25.00	40.00

(注)前期(平成23年12月期)配当実績の内訳 普通配当 30円00銭 株式上場20周年記念配当 10円00銭

修正の理由

当社は利益配分に関する基本方針として、1株当たり年間20円の配当を安定的利益還元のベースとした上で、連結配当性向30%を目途として業績向上による一層の利益還元を実施してまいりました。
連結業績予想の修正に記載しましたとおり、前回予想より利益が減少する見込みとなったため、配当方針に従い、期末配当を前回予想比5円減の15円とし、年間配当を1株当たり30円とする予定であります。

以 上